

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-23

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 现场参观 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 其他（_____）
活动参与人员（排名不分先后）	万联证券、富安达基金、华源证券、财通证券、瑞士银行（中国）、工银安盛资产、国海证券、美林（亚太）、柏骏资本（香港）、大成基金、野村国际（香港）、深圳市弘洛私募证券基金、长城基金、华创证券、和谐健康保险、深圳市凯丰投资、天风证券、申万宏源证券、朱雀基金、华鑫证券、华泰证券、东方证券、太平资产、创金合信基金、北京鸿道投资、东北证券、中银基金、永赢基金、爱建证券、浩成资产、诺安基金、耕霖（上海）投资、光大证券、中银国际证券、UG INVESTMENT ADVISERS LTD、浙江国信投资、开源证券、相聚资本、冯源（宁波）私募基金、汇添富基金、博时基金、德邦基金、东莞证券、国金证券、浦银国际证券、北京神农投资、华福证券、甬兴证券、泰康资产、摩根大通证券（中国）、长盛基金、瑞银证券、摩根证券投资信托、摩根士丹利基金（中国）、野村东方国际证券、中原证券、复星财富国际、汇丰前海证券、富瑞金融集团香港、香港上海汇丰银行、中国银河证券、广东宝新投资发展、中泰证券、中荷人寿保险、上海熇盈私募基金、珠海景瑞私募基金、上海时弈私募基金、HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited、上海摩旗投资、民生加银基金、富国基金、鲍尔赛嘉（上海）投资、中信里昂证券、中财招商投资集团有限公司、三星资管（香港）、中国人寿、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、西部证券、泓德基金、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）、上海十溢投资、北京禹田资本、天弘基金、广发证券、上海同犇投资管理中心（有限合伙）、玄卜投资（上海）有限公司、中信证券、Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd、Morgan Stanley、中信保诚基金、上海朴信投资、招商证券、建银国际证券、江苏瑞华投资、东亚前海证券、华西证券、中信建投证券、汇安基金、花旗环球金融亚洲、国泰海通证券、贝莱德资产管理、国信证券、长江证券创新投资（湖北）
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书：张丽君；证券事务主管：阳佩琴

时间	2026 年 10 月 23 日
地点	网络及电话会议
形式	网络及电话会议
投资者关系 活动主要内容介绍	交流主要内容： Q1、请介绍公司 2026 年三季度经营业绩情况。 2026 年三季度，公司实现营业收入 104.78 亿元，同比增长 66.29%；归母净利润 18.78 亿元，同比增长 94.42%；扣非归母净利润 18.58 亿元，同比增长 102.78%。上述变动得益于 AI 算力基础设施投资、产品迭代升级带来的市场机遇，带动 PCB、封装基板及 PCBA 业务相关需求增长。其中 AI 加速卡、服务器及相关配套产品需求持续提升，高速交换机、光模块收入明显增长，应用处理器类及存储类封装基板订单收入快速释放，产品结构持续优化；叠加广州、南通生产基地产能稳步爬坡，推动营业收入及利润实现同比增长。 Q2、请介绍 2026 年三季度公司综合毛利率环比变化情况。 2026 年三季度，公司综合毛利率环比有一定提升，主要得益于 PCB 数据中心、有线通信业务收入持续增长，PMIC 及处理器芯片类封装基板订单收入快速释放，产品结构持续优化，叠加广州工厂、南通四期、泰国工厂稳步爬坡，助益公司综合毛利率提升。 Q3、请介绍 2026 年三季度公司 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。 PCB 产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。2026 年三季度，公司 PCB 业务收入环比明显增长，数据中心领域收入占比提升，有线通信业务收入持续增长，其余业务领域占比与二季度基本一致。 Q4、请介绍 2026 年三季度封装基板业务经营拓展情况。 公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片类封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2026 年三季度，PMIC 和处理器芯片类封装基板产品收入快速增长、占比提升。

	Q5、请介绍广州封装基板项目爬坡进展。 2026 年三季度，公司广州生产基地产能稳步释放，产品线能力持续提升。其中，BT 类封装基板产能爬坡稳步推进；FC-BGA 类封装基板已具备 26 层及以下产品批量生产能力，30 层及以上产品的技术研发及打样工作按期推进中。 Q6、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。 公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2026 年三季度，受大宗商品价格变化影响，金盐等部分原材料价格同比提升、环比亦有一定涨幅。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。 Q7、请介绍公司 2026 年三季度资本开支的方向。 2026 年三季度，公司资本开支主要聚焦 PCB 与封装基板业务，重点投向无锡、南通、广州项目建设；同时适时开展技术改造，打开瓶颈、释放产能。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无